DOI: 10.19113/sdufenbed.508867

Korning Cam ve Si Alttaşlar Üzerine RF Magnetron Püskürtme ile Büyütülen SnO2 İnce Filmlerin Derinlik Profil Analizi

Nihan AKIN SÖNMEZ*1,2 💿

¹ Gazi Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 06374, Ankara, Türkiye ²Gazi Üniversitesi, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 06500, Ankara, Türkiye

(Alınış / Received: 06.01.2019, Kabul / Accepted: 23.07.2019, Online Yayınlanma / Published Online: 30.08.2019)

Anahtar Kelimeler

RF püskürtme, SnO₂, İnce film, SiO₂ ara-tabaka, SIMS **Özet:** Tetragonal yapıdaki SnO₂ ince filmleri (100) yönelimli n-tipi Si ve korning cam alttaşlar üzerine oda sıcaklığında RF magnetron püskürtme tekniği ile büyütüldü. Büyütülen yapıların atomik dağılımı ve arayüzey durumları, İkincil İyon Kütle Spektrometresi analizlerinden elde edilen derinlik profili spektrumları ile değerlendirildi. Film derinliği boyunca Sn ve O atomik dağılımının homojen dağılım sergilediği görüldü. Bununla birlikte, Si alttaş üzerine büyütülen SnO₂ filmi ile Si alttaş arasında çok ince bir SiO₂ tabakasının oluştuğu, hassas bir şekilde SIMS tekniği ile belirlendi. Oluşan SiO₂ ara-tabaka kalınlığının, püskürtme kinetiğine -RF büyütme gücüne- bağlı olduğu belirlendi.

Depth Profile Analysis of SnO₂ Thin Films Deposited on Corning Glass and Si Substrates by RF Magnetron Sputtering

Keywords RF sputtering,

SnO₂, Thin film, SiO₂ interlayer, SIMS **Abstract:** SnO_2 thin films having tetragonal structure were grown on (100) oriented n-type Si and corning glass substrates at room temperature with RF magnetron sputtering technique. The atomic distribution and interfacial evaluation of the deposited structures were evaluated with the depth profile spectra obtained by the Secondary Ion Mass Spectrometer. It was seen that the atomic distribution of Sn and O showed a uniform distribution throughout the film depth. However, it was precisely determined by SIMS technique that an ultra-thin SiO₂ layer was formed between the SnO₂ film, which was deposited on Si, and Si substrate. The formed SiO₂ interlayer thickness was determined to be dependent on the sputtering kinetics i.e. RF deposition power.

1. Giriş

Kalay Oksit (SnO₂) ince filmler, üstün elektro-optik, kimyasal kararlılık ve yapısal özelliklerden dolayı geniş ilgi gören yarıiletken malzemelerden biridir. 3.8 eV gibi geniş bir enerji bant aralığına sahip SnO2 filmleri; gaz sensörleri, biyosensörler, düşük emisyonlu kaplamalar, fotoiletkenler, şeffaf iletken elektrotlar, güneş hücreleri ve Lityum iyon pilleri gibi birçok aygıtın geliştirilmesinde kullanılan nitelikli nanoteknolojik bir malzemedir [1-7]. Atomik dağılımlarının derinlik boyunca homojen dağılması, filmlerin fiziksel özgün karakterlerini taşıyabilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu ise filmlerin kullanım teknolojik cihazlarda olan verimliliğini/etkinliğini belirleyen en önemli parametrelerden biridir. Öte yandan, ince filmlerin alttaş arayüzeylerinde meydana gelebilen atomik difüzyon ve alttaş etkileşmesi ile farklı yapıların

olusumu aygit performansini olumlu-olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde SnO_2 filminin cam gibi alttaşlar üzerine büyütüldüğünde Sn ve O2'nin film derinliği boyunca homojen dağılımı hem elektriksel hem de optik özelliklerini etkilemektedir. Bu filmlerin Si alttaş üzerine büyütüldüğü durumda ise atomik dağılımın düzgünlüğü oluşsa dahi SnO2/Si ara yüzeyinde SiO2 ara-tabakasının oluşması, film performansını negatif olarak etkileyebilmektedir [8]. Bu SiO₂ aratabakasının olusumunun film büyütme sartlarından etkilendiği ve bu ara-tabakanın belirlenmesinin önemi literatürde rapor edilmiştir [9,10]. Arayüzeyde oluşan SiO₂ filmi, çok ince olabileceğinden, hassas olarak belirlenmesi zordur ve belirlenebilmesi için gelişmiş tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu teknikler arasında yüksek çözünürlüğü nedeniyle geçirgenlikli elektron mikroskobi (TEM) tekniği ve elementel, izotopik veya nanometre skalada

moleküler bileşimi ppm mertebesinde belirleme imkanı veren SIMS tekniği öne çıkmaktadır. Literatürdeki bir çalışmada düşük basınç CVD tekniği ile Si alttaş üzerine büyütülen SnO₂ filmi ile Si alttaş arasında ince bir SiO2 ara-katmanının varlığı TEM ile belirlenmiştir [10]. SiO2 ara-katmanının SnO2/Si yapısında geliştirilen güneş hücresinin fotovoltaik dönüşüm verimliliğini olumlu etkilediği gözlenmiştir [11]. Literatür incelendiğinde bu konudaki çalışmaların son derece az olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışmada, (100) yönelimli n-Si alttaş üzerine SnO2 hedefi kullanılarak RF magnetron püskürtme tekniği ile büyütülen SnO2 filmi için bu ince SiO₂ ara-katmanının varlığı, literatür bilgisi dahilinde, bir ilk olarak SIMS tekniği ile yapılan derinlik profili analizi ile belirlendi. Bu calısmada avnı zamanda, korning cam üzerine büyütülen SnO₂ filminin atomik dağılımı ve SnO₂/cam arayüzeyindeki atomik dağılımın keskinliği de irdelendi. Oda sıcaklığında büyütülen SnO2 filmlerinin, atomik dağılım homojenliğinin belirlenmesi ve özellikle Si alttaş üzerine büyütülmelerinde arayüzeyde oluşan SiO₂ ara-katmanının varlığının belirlenmesi sayesinde bu çalışma ile, SnO2 filmlerin yüksek sıcaklıkta büyütülmeleri ve/veya büyütme sonrası ısıl işlemlerinde ortaya çıkma ihtimali olan arayüzey durumlarına ışık tutması beklenmektedir.

2. Materyal ve Metot

SnO2 ince filmleri oda sıcaklığında korning cam ve (100) yönelimli n-Si alttaşlar üzerine RF (radyo frekansı) magnetron püskürtme tekniği (Bestec marka) ile 75 W, 100 W ve 125 W gücünde ve işlem gazı olarak Ar gazı atmosferinde 3.2 mTorr işlem basıncında büyütüldü. Kaplama öncesi, korning cam alttaşlar ilk olarak yumuşak sabun çözeltisinde temizlendi, daha sonra deiyonize su içinde iyice yıkandı. Son olarak ise 15 dakika boyunca aseton içerisinde ultrasonik banyoda bekletildi. Sonrasında Azot gazı ile kurutulan cam alttaşlar püskürme sistemine yüklendi. n-Si alttaşlar ise öncelikle kimyasal yöntemle yüzeylerindeki oksit tabaka temizlendikten sonra püskürtme sisteminin magazin odasına yüklendi. Püskürtme sistemi icerisinde ve yüksek vakum altında (10⁻⁶ mTorr) Si alttaş kaplama odasına yüklenmeden önce, RF ters püskürtme ile, muhtemel oksit oluşumunun uzaklastırılması amacıyla, aşındırılarak yüzeyinin tamamen oksitten temizlenmesi sağlandı. Kaplama odasının başlangıç basıncı 10⁻⁸ mTorr sağlanacak şekilde sistem pompalandı. Alttaşlar üzerine filmler, % 99.99 saflıkta 4 inch çapında SnO_2 hedef kullanılarak büyütüldü. Büyütme süresince alttaş-hedef arası mesafe sabit 30 mm olarak ayarlandı. Filmlerin kalınlığı 200 nm olarak in-situ bir kalınlık ölcer kullanılarak ölçüldü. n-Si üzerine büyütülen SnO2 filmlerinin kristalizasyonu APD 2000 Pro XRD cihazı CuK α 1 (λ =1.54178 Å) ışını ile ω -2 θ kullanılarak modunda belirlendi. Filmlerin vüzev tarama morfolojileri Nanomanyetik marka AFM cihazı ile

gözlendi. Büyütülen filmlerin atomik homojenliğini belirlemek için, derinlik profilleri 10^{-10} Torr'luk taban basıncında O⁻ ve Cs⁺ iyon tabancaları ile Hiden SIMS Workstation kullanılarak ölçüldü. O⁻ ve Cs⁺ iyon tabancalarının püskürtme parametreleri sırasıyla, 3500 eV enerji, 400 nA demet akımı ve 5 keV enerji, 40 nA demet akımı olarak ayarlandı. İkincil iyonlar ise kütle spektrometresi yardımı ile 100-1000 µm² merkezi krater alanından toplandı.

3. Bulgular

Bu çalışmada, 200 nm kalınlıklı SnO2 ince filmleri RF magnetron püskürtme ile n-tipi Si ve korning cam alttaşlar üzerinde biriktirildi. n-Si üzerine büyütülen filmlerin ω -2 θ XRD desenleri Sekil 1'de verildi. 75 W. 100 W ve 125 W RF gücü ile büyütülen filmlerin (200) ve (220) düzlemlerine ait kırınım pikleri, sırasıyla, 38^o ve 52.5^o civarında gözlendi. Piklerin bu pozisyonları, büyütülen filmlerin tetragonal yapıda polikristal SnO₂ filmi (JCPDS Card No. 41-1445) olduklarını göstermektedir. (200) kırınım pikinin maksimum yarı genişliği (FWHM), 75 W, 100 W ve 125 W'da büyütülen filmler için, sırasıyla β=0.38⁰, 0.36° ve 0.320; Schrerr denklemine $(D=0.89\lambda/\beta Cos(\theta))$ göre [12] parçacık büyüklükleri 38.17 nm, 40.29 ve 45.33 nm olarak hesaplandı.



Şekil 1. 75 W, 100 W ve 125 W RF gücünde büyütülen SnO₂ filmlerinin XRD deseni

Büyütülen filmlerin 3x3 µm²'lik alanda AFM ile alınan 3 boyutlu yüzey görüntüleri Şekil 2'de verildi. görüldüğü Şekilden gibi, üretilen filmlerin, literatürden bilinen metal-oksit yüzey morfolojisine uvgun olduğu, dolayısıyla, SnO₂ filmlerinin her iki RF kaplama gücünde düzgün film morfolojisinde büyütüldüğü anlaşıldı. Elde edilen bu morfolojilerden, 75 W'da büyütülen filmin yüzeyinin daha homojen olduğu değerlendirildi. Elde edilen yüzey görüntülerinden ortalama yüzey pürüzlülük değeri (RMS), 75 W'da büyütülen SnO2 filmi için 14.33 nm iken 100 W ve 125 W'da büyütülen filmler için bu değerin 16.04 ve 19.26 nm'ye yükseldiği belirlendi. Yüksek kaplama gücünde oluşan RMS değerindeki bu artışın, XRD sonuçlarında da belirlendiği gibi, parçacık büyüklüğü ile ilişkili olduğu değerlendirildi.



Şekil 2. (a) 75 W (b) 100 W ve (c) 125 W RF gücünde büyütülen SnO_2 filmlerinin AFM yüzey morfolojileri

Filmlerin derinlik profili, atomik homojenliği ve arayüzey özellikleri SIMS ile analiz edildi. Yapıdaki ana elemanların (Sn, O ve Si), oluşan ikincil iyonları kütle spektrometresi ile tespit edildi. Sn'in atomik dağılımı Oksijen (O₂), Si ve O'nin atomik dağılımları ise Sezyum (Cs) iyon tabancaları kullanılarak belirlendi. Ayrıca, korning cam üzerindeki filmler için CsO, CsSn ve CsSi kümelerinin ve Si alttaş üzerindeki filmler için SiO2 molekülünün yine Cs iyon tabancası ile bombardımanı sonrası kütle sayımı da başarıldı. Si ve cam alttaşlar üzerindeki SnO2 filmlerinin derinlik profilleri, sırasıyla, Sekil 3 (a) ve (b)'de verildi. Nanometre skalada aşındırılarak oluşturulan SIMS kraterinin derinliği iğne uçlu (stylus) profilometre (Dekdak-150) ile ölçüldü. Bu ölçüm sonucunda, başlangıçta 200 nm hedefli olarak büyütülen filmlerin kalınlıklarının 218 nm civarında olduğu görüldü.



Şekil 3. (a) Si ve (b) cam alttaşlar üzerindeki SnO₂ filmlerinin derinlik profilleri

SIMS spektrumu değerlendirildiğinde yapıyı oluşturan Sn ve O atomlarının alttaş yüzeyine kadar homojen olarak yerleştikleri her iki profilde de (Si ve cam alttaş üzerinde) görülmektedir. Bu ise filmlerin derinlik boyunca homojen büvüdüğünün bir göstergesidir. Ayrıca, SnO2/Si-alttaş arayüzeyinde Sn ve O atomları keskin bir şekilde sıfır düzeylerine inmesi büyütülen SnO₂ filmlerinin alttas arayüzeylerinin düzgün olduğu kanaatini olusturmaktadır.

Bu çalışmada, belirlenmesi oldukça zor olan arayüzeyde oluşan çok ince SiO2 filminin SIMS ile tespit edilmesi önemli görülmektedir. Bu gözlem, ntipi Si alttaşın yüzeyinde SiO2 tabakasının oluştuğunu anlatmaktadır. SnO2 filminin aynı ortamda korning üzerine büyütüldüğü yapı için cam SIMS spektrumunda SiO₂ katmanı görülmemektedir. Bu durum cam yüzeyi ile oksidin reaksiyon etkileşmesi olmadan büyüdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, SnO₂'nin Si üzerine magnetron püskürtme ile büyütülmesinde, püskürtme kinetiğinin etkili olduğu ve Si yüzeyinde bulunan muhtemel boş bağlar ile O2'nin bağ yaptığı şeklinde değerlendirilebilir. 75 W, 100 W ve 125 W'da büyütülen numunelerdeki SiO2 kalınlıkları atomik dağılım profilinden, sırasıyla, 3.34 nm, 3.98 ve 4.86 nm olarak belirlendi. 75 W'da oluşan SiO2'nin nispeten daha ince olması, artan RF püskürtme gücü bu kalınlığın artması, püskürtme kinetiğinin SiO2 oluşumunu etkilediği düşüncesini desteklemektedir. Sonuc olarak. SnO2 ince filmlere dayalı geliştirilen güneş hücreleri [8] ve NO2 gaz algılama sensörleri [9] için SiO₂ varlığı aygıtların performanslarını olumlu etkilediği bilinmektedir ve bu nedenle, bu koşullarda üretilen SnO2 filmlerin bahsedilen aygıtlarda kullanılabilirliği öngörülmektedir.

4. Tartışma ve Sonuç

SnO₂ filmlerin RF magnetron püskürtme tekniği ile n-Si ve korning cam atttaş üzerine tetragonal yapıda büyütülmesi başarıldı. SIMS tekniği ile SnO₂ filminin derinliği boyunca Sn ve O atomik dağılımının homojen olduğu belirlendi. SnO₂/Si arayüzeyinde, çok ince bir SiO₂ tabakasının oluştuğu, arayüzeydeki atomik dağılımın SIMS tekniğinin yüksek hassasiyeti ile belirlendi. Oluşan SiO₂ tabakasının kalınlığının, magnetron püskürtme tekniğinin kinetiklerine bağlı olduğu ve RF kaplama gücü ile azaldığı belirlendi. Oluşan ince SiO₂ filminin, elektro-optik aygıt fonksiyonuna bağlı olarak, Si yüzeyinde pasivasyon rolü üstlenebileceği açısından olumlu olabileceği, ancak, şeffaf elektrot kullanımında seri direnci artırabileceği değerlendirilmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma 2016K121220 nolu proje ile Cumhurbaşkanlığı SBDB tarafından desteklenmektedir.

Kaynakça

 Liu. K., Sakurai, M., Aono, M. and Shen, D. 2015. Adv. Func. Mater., 25-21(2015), 3157-3163.

- [2] Lee, J., Kim, N.H., Park, Y.S., 2016. Organic Solar Cells. J. Nanosci. Nanotechnol., 16-5(2016), 4973-7.
- [3] Alshammari, F.H., Hota, M.K., Wang, Z., Husam, H.A. and Alsharee, N. 2017. Adv. Electron. Mater., 9-3(2017), 1700155.
- [4] Banyamin, Z.Y., Kelly, P.J., West, G., and Boardman J. 2014. Coatings, 4(2014), 732-746.
- [5] Li, C., Lv, M., Zuo, J. and Huang X. 2015. Sensors, 15(2015), 3789-3800.
- [6] Tığ, G.A., Zeybek, D.K. and Pekyardımcı, Ş. 2016. Chemical Papers, 70(2016), 695-705.
- [7] Min, X., Sun, B., Chen, S., Fang, M., Wu, X., Liu, Y., Abdelkader, A., Huang, Z., Liu, T., Xi, K., Kumar, R.V. 2019. Energy Storage Materials, 16(2019), 597-606.

- [8] Jeong, J. 2018. Scanning, 2018(2018) 4592913.
- [9] Karthigeyan, A., Gupta, R.P., Burgmair, S.K., Sharma, M., Eisele, I. 2002. Sensors and Actuators B, 87(2002), 321–330.
- [10] Jeong, J., Na, D.S., Lee, B.J., Song, H.J. and Kim, H.G. 2012. Current Applied Physics 12-1(2012). 303–306.
- [11] Singh, K. and Tamakloe, R. Y. 1996. Solar Energy, 56-4(1996), 343-348.
- [12] Al-Ghamdi, A.A., Al-Hartomy, O.A., El Okr, M., Nawar, A.M., El-Gazzar, S., El-Tantawy, F., Yakuphanoglu, F. 2014. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 131(2014). 512-517.